

《化合物半导体》编辑计划

刊期	Feb/Mar Issue: date: 2/26 Materials: 2/13 Ad booking: 2/06 Editorial: 1/26	Apr/May Issue: date: 4/22 Materials: 4/15 Ad booking: 4/08 Editorial: 3/25	Jun/Jul Issue: date: 6/24 Materials: 6/17 Ad booking: 6/10 Editorial: 5/27	Aug/Sep Issue: date: 8/26 Materials: 8/19 Ad booking: 8/12 Editorial: 7/29	Oct/Nov Issue: date: 10/28 Materials: 10/21 Ad booking: 10/14 Editorial: 9/23	Dec/Jan Issue: date: 12/23 Materials: 12/16 Ad booking: 12/9 Editorial: 11/25
封面故事	AR/VR应用	光子集成	液相法碳化硅	金刚石半导体生长	数据中心应用	智能电网应用
技术	可见光通信	Micro-LED	VCSEL激光器	AI应用	电动汽车应用	氧化镓晶体生长
专栏	GaN电力电子器件	SiC衬底	GaN衬底	氧化镓二极管	金刚石半导体器件	SiC-IGBT
特别报道	SiC电力电子器件	氮化铝	InP 光电子器件	氧化镓MOS	氧化镓外延	BN材料
展会派发	·Semicon China Shanghai, Mar ·Laser World of Photonics China, Shanghai, Mar	·SNEC International PV Power Expo, May	·Guangdong Int'l Lighting Fair, Jun	·Semicon Taiwan, Sept ·CIOE, Sep, Shenzhen EDICON China, Sep	·China Solid-State Lighting, Nov	

电子快讯编辑计划

日期	题目
Jan 9	SiC电力电子器件
Feb 06	金刚石半导体生长
Mar 13	氧化镓晶体生长
Apr 10	电动汽车应用
May 15	GaN射频器件
Jun 12	氧化镓器件
Jul 17	光子集成
Aug 14	深紫外LED
Sep 11	AlN材料
Oct 16	GaAs器件
Nov 13	InP 光电子器件
Dec 18	VCSEL激光器